



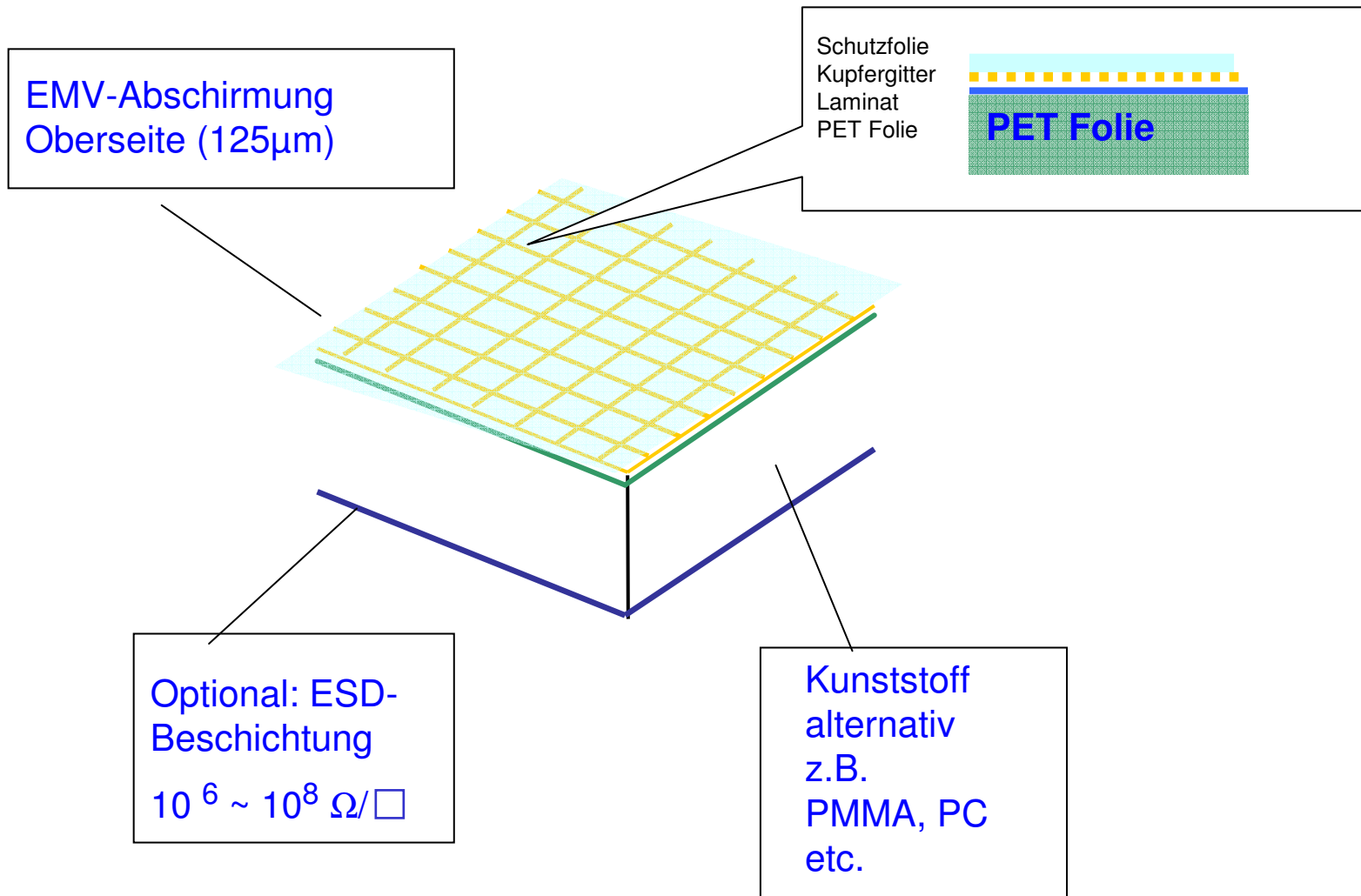
ESLON-MC Kunststoffplatten EMV-Schutz

- ESLON-MC Kunststoffplatten eignen sich für die elektromagnetische Abschirmung von Gehäusen in der Elektronikindustrie. Optional lieferbar sind Ausführungen mit einer elektrostatisch ableitfähigen Beschichtung (ESD-Schutz).
- ESLON-MC Kunststoffplatten verfügen über eine hervorragende Abschirmung im Frequenzbereich zwischen 100 MHz und 1GHz.
- ESLON-MC Kunststoffplatten sind in einer Vielzahl von Kunststoffmaterialien erhältlich. Gleichfalls erhältlich sind unterschiedliche Farbvarianten.
- ESLON-MC Kunststoffplatten können in kundenspezifischen Größen bei einer geringen Mindestmenge bezogen werden.
- ESLON-MC Kunststoffplatten ermöglichen die Optimierung der Abschirmung für verschiedenste Einsatzanforderungen.

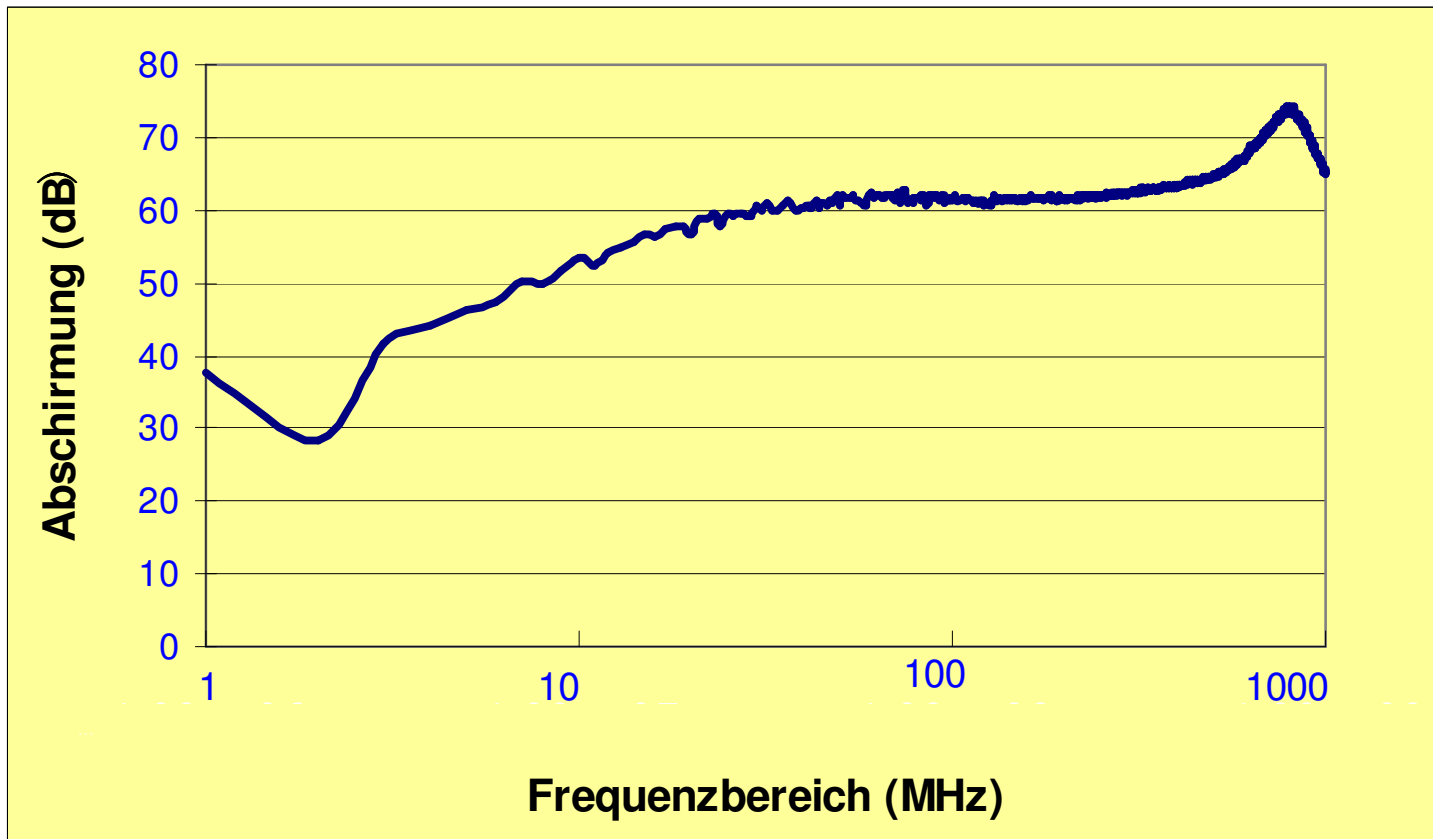
Sekisui Chemical GmbH Cantadorstr. 3 D-40211 Düsseldorf
Tel: +49-211-36977-0 Fax: +49-211-36977-31

www.eslon.de www.sekisui.de info@sekisui.de

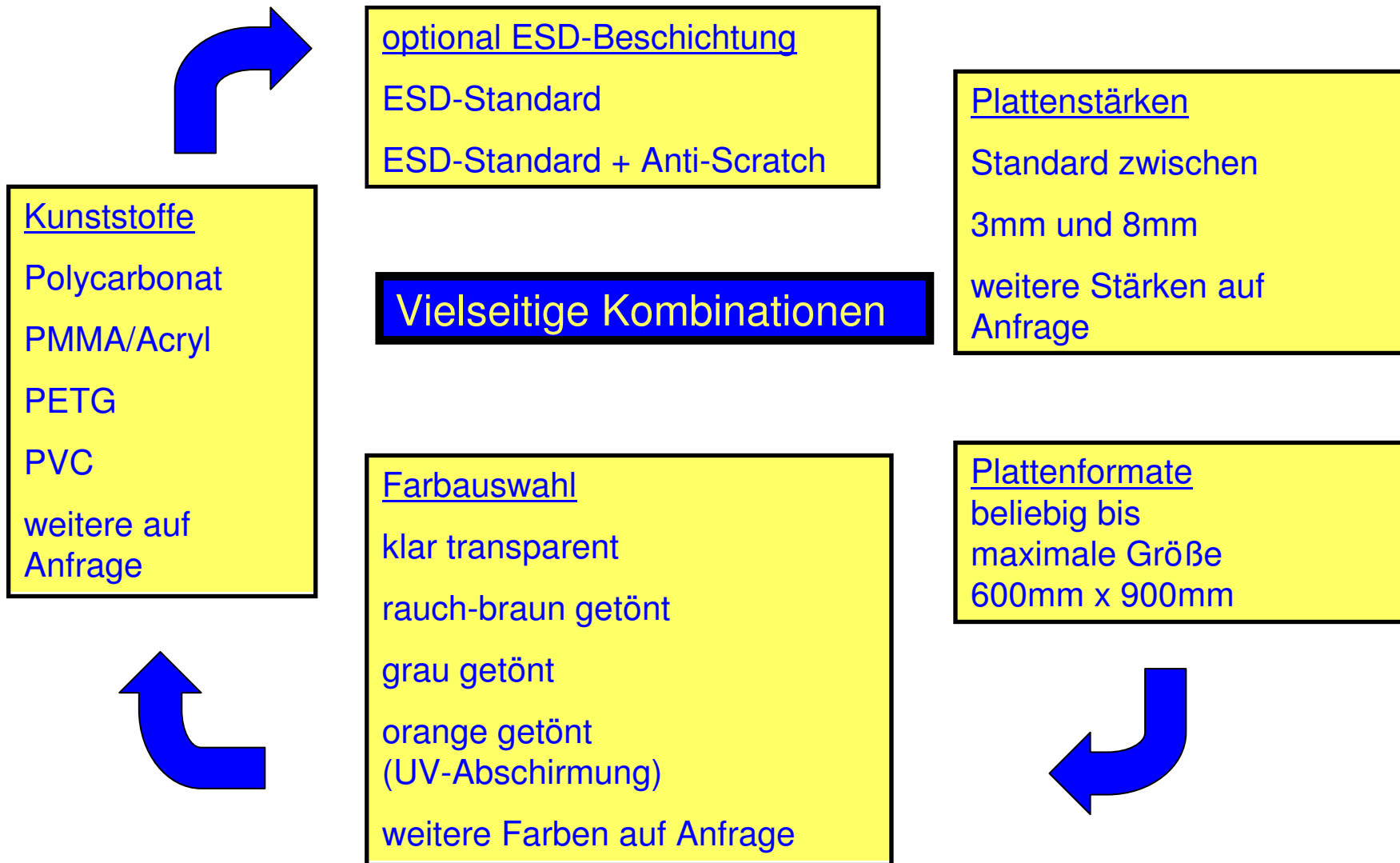
ESLON-MC Struktur



ESLON-MC Kunststoffplatten EMV-Abschirmung



ESLON-MC Kunststoffplatten Lieferübersicht

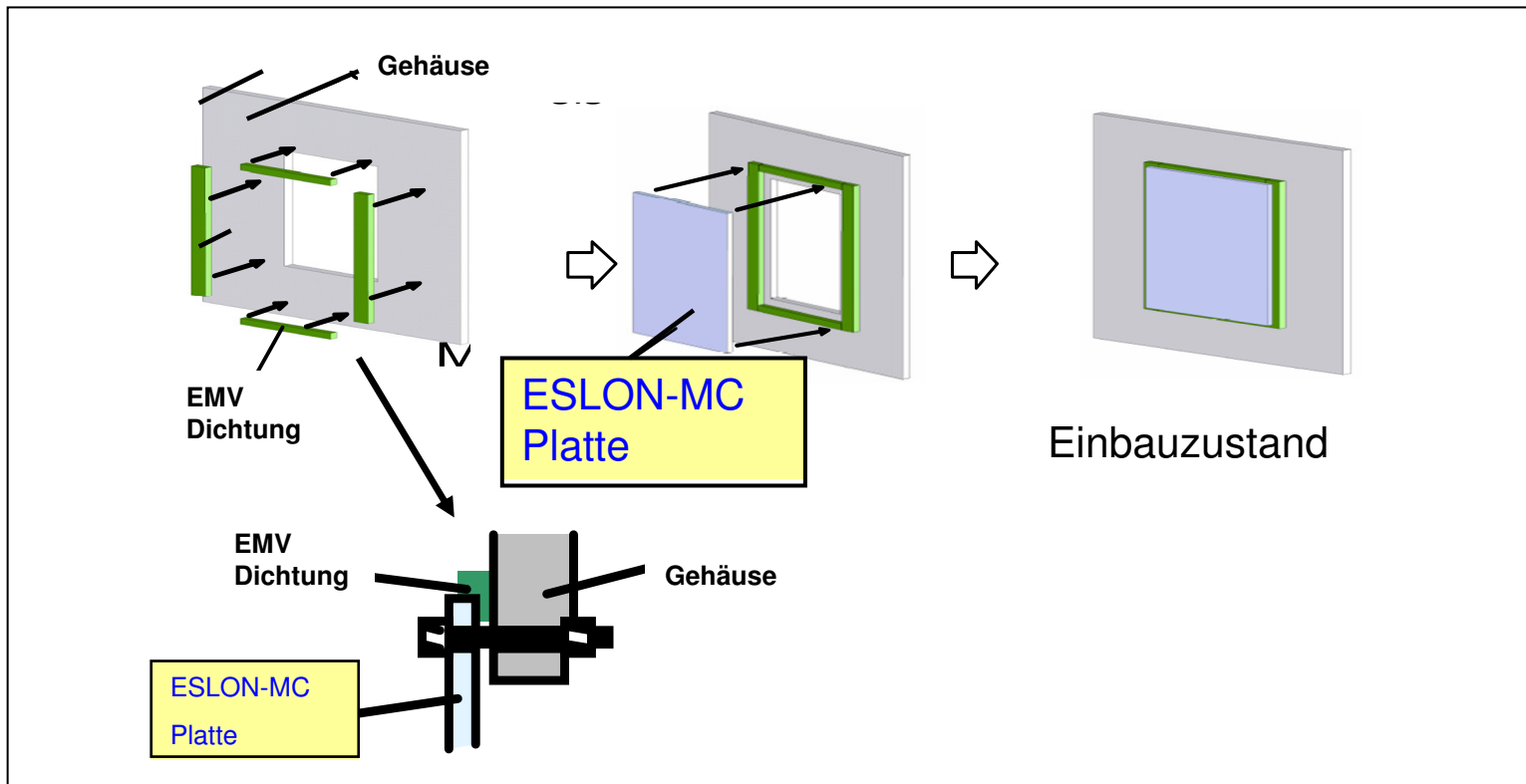


ESLON-MC Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften (typische Werte bei 5mm)	Einheit	Meßverfahren	Polycarbonat klar ESD-Standard + Anti-Scratch
Abschirmung	dB	KEC Methode 500 MHz	62
Transmittanz	%	ASTM D-1003	53
Trübung	%	ASTM D-1003	35
Oberflächenwiderstand (für ESD/Antistatik Option)	Ω/\square	DIN 53482	$10^6 \sim 10^8$
Bleistifritzhärte (für ESD/Anti-Scratch Option)	-	JIS K5400	H
Zugfestigkeit	N/mm ²	DIN 53455	65
Zugmodul	N/mm ²	DIN 53455	2300
Kerbschlagzähigkeit	kJ/m ²	JIS K7111	10
Vicat Erweichungstemperatur	°C	JIS K7206	65

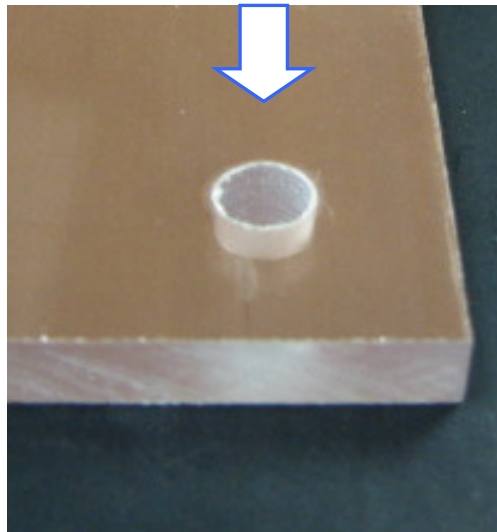
ESLON-MC Installationshinweise

Erdung: Um einen optimalen Schutz vor elektromagnetischen Störungen zu erzielen, empfiehlt es sich, ESLON-MC fachgerecht zu erden. Nach dem Entfernen der Schutzfolie erfolgt die Erdung durch eine abschirmende Dichtung (siehe Abbildung)



ESLON-MC Installationshinweise

Verarbeitung: Das Einbringen von Bohrungen muss unbedingt von der EMV-Schutzseite (Oberseite) aus erfolgen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung der EMV-Schutzseite durch Ausfransungen an der Bohrstelle.



Bohrung ausgehend von der EMV-Schutzseite (Oberseite)



Bohrung von der Unterseite durch die EMV-Schutzseite (Oberseite):
ausgefranstes Bohrloch